

技术参数

2315

日期：08/2025

应用介绍

特点

一款单组份紫外光固化胶黏剂，UV光快速固化；用于电子行业芯片金线包封；具有低硬度，无色透明，以及较好的可靠性，特别适合金线保护的应用。

粘接材料

金属，塑料，玻璃，陶瓷等

典型应用

电子行业芯片金线包封

固化前特性

特征	数值	测试方法
化学名称	丙烯酸树脂	
颜色	无色	
粘度(cps)	3000	20rpm@25℃, ASTM D-1084
触变指数	2.9	
固化条件*	1200mJ/cm ² @365nm	
有效期@ 5-10℃,月	6	

固化后特性

特征	数值	测试方法
外观	无色	
邵氏硬度	48A	ASTM D-2240
拉伸强度	1.1MPa	
断裂伸长率	156%	
剪切强度	0.8MPa	PC/PC
CTE	299ppm/℃	

储存和使用方法

产品在 5-10℃环境中储存，避免阳光直射，使用前回温 2H；使用胶水时应避免眼睛和皮肤接触，对于接触部位应及时使用肥皂和清水清洗。其他使用注意事项请参考 SDS 文件；

注：

1. 本技术数据表(TDS)中提供的信息和应用建议是基于截至 TDS 更新日时，我们对本产品的了解和经验而编写，数据不作为质检标准。该产品可以有各种不同的应用，差异化的应用和工作环境会超出我们的控制范围，因此我们对产品的适用性不承担责任，强烈建议您在使用前做完整的产品和工艺匹配测试，并以此来评估确认该产品的适用性。
2. 本文档的内容可能会有更新，除非有明确的书面承诺，禧合没有义务通知用户关于内容的更改。

